

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-68

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
活动参与人员（排名不分先后）	国海证券、长江证券、太平洋资产管理、前海再保险、前海人寿、苏银理财、中银理财、工银理财
上市公司接待人员	战略发展部总监、证券事务代表：谢丹；投资者关系经理：郭家旭
时间	2024年11月12日
地点	公司会议室
形式	实地调研
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司主营业务基本情况。</p> <p>公司专注于电子互联领域，拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项主营业务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局，印制电路板与封装基板业务“技术同根”，电子装联与印制电路板业务“客户同源”，三项业务在各自领域相继拓展的同时，高效协同共筑起公司电子电路互联技术能力平台。公司具备提供“样品→中小批量→大批量”的综合制造能力，通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务，能够为客户提供专业高效的一站式综合解决方案。业务产品下游应用广泛，拥有较为深厚的行业积淀和扎实的客户基础。</p> <p>Q2、请介绍公司2024年三季度经营业绩情况。</p> <p>2024年前三季度，公司累计实现营业收入130.49亿元，同比增长37.92%，归母净利润累计实现14.88亿元，同比增长63.86%，扣非归母净利润累计实现13.76亿元，同比增长</p>

86.67%。单季度层面，2024 年第三季度公司实现营业收入 47.28 亿元，同比增长 37.95%，归母净利润实现 5.01 亿元，同比增长 15.33%，扣非归母净利润实现 4.72 亿元，同比增长 51.53%。

上述变动主要得益于公司把握 2024 年以来行业结构性机会，加大各项业务市场拓展力度，报告期内订单同比增长，三项主营业务收入均实现同比增长，同时由于 AI 的加速演进及应用深化，叠加汽车电动化/智能化趋势延续，以及服务器总体需求回温等因素，推动公司产品结构优化，助益利润同比提升。

Q3、请介绍公司 2024 年第三季度营业收入及综合毛利率环比变化情况。

2024 年第三季度，公司营业收入 47.28 亿元，环比增长 8.45%，主要由于电子装联业务项目结算增加影响，营收规模环比增加。公司综合毛利率环比略有下降，一方面由于电子装联业务规模增长（因业务形态特点，其毛利率一般略低于公司综合毛利率）；同时封装基板及 PCB 业务受产品结构变化影响，业务毛利率环比下降。此外，广州封装基板新工厂产能爬坡、原材料涨价对第三季度综合毛利率也造成一定负向影响。

Q4、请介绍公司 2024 年第三季度 PCB 业务各下游领域经营拓展情况。

公司 PCB 业务产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。2024 年第三季度，受通用服务器需求及国内汽车电子产品需求增长影响，公司 PCB 业务营收在数据中心及汽车电子领域环比二季度有所提升，通信领域受无线侧通信基站相关产品需求无明显改善影响，营收占比有所下降。

Q5、请介绍公司对汽车电子市场的布局逻辑以及技术优势。

与传统汽车电子产品相比，公司所聚焦的新能源和 ADAS 领域对 PCB 在集成化等方面的设计要求更高，工艺技术难度有所提升。例如 ADAS 领域相关产品对车载通信及数据处理能力要求更高，涉及高频材料、HDI 工艺、小型化等复杂设计。伴随汽车电动化/智能化趋势的延续及未来车联网等终端应用的涌现，汽车也可能演变为新型的移动数据终端，公司在通信领域积累的技术优势可进一步延伸。

Q6、请介绍公司 PCB 业务有无进一步扩产的空间。

公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及未来泰国项目均设有工厂。一方面，公司可通过对现有成熟 PCB 工厂进行持续的技术改造和升级，增进生产效率，释放一定产能；另一方面，公司在南通基地尚有土地储备，具备新厂房建设条件，南通四期项目已有序推进基建工程，拟建设为具备覆盖 HDI 等能力的 PCB 工艺技术平台。公司将结合自身经营规划与市场需求情况，合理配置业务产能。

Q7、请介绍公司泰国项目规划及当前建设进展。

公司为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，在泰国投资建设工厂，总投资额为 12.74 亿元人民币/等值外币。目前基础工程建设有序推进中，具体投产时间将根据后续建设进度、市场情况等因素确定。

Q8、请介绍公司 2024 年第三季度封装基板业务经营拓展情况。

公司封装基板业务产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。2024 年第三季度，封装基板下游市场需求有所放缓，公司封装基板产品结构随下游市场需求波动有所调整。

Q9、请介绍公司 2024 年第三季度 PCB 及封装基板工厂稼动率较第二季度变化情况。

公司 2024 年第三季度 PCB 工厂稼动率环比基本持平，维持在高位水平；封装基板工厂稼动率随下游部分领域需求波动略有回落。

Q10、请介绍广州封装基板项目连线爬坡进展。

公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力在今年上半年快速提升，目前其产能爬坡尚处于前期阶段，重点仍聚焦平台能力建设，推进客户各阶产品认证工作。

Q11、请介绍公司封装基板业务在 FC-BGA 技术能力方面取得的进展。

公司 FC-BGA 封装基板已具备 16 层及以下产品批量生产能力，16 层以上产品具备样品制造能力，其中 20 层产品送样认证工作有序推进中。公司后续将进一步加快高阶领域产品技术能力突破和市场开发，同时也将继续引入该领域的技术专家人才，加强研发团队培养，

	<p>提升巩固核心竞争力。</p> <p>Q12、请介绍公司对电子装联业务的定位及布局策略。</p> <p>公司电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，按照产品形态可分为 PCBA 板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信及数据中心、医疗、汽车电子等领域。公司发展电子装联业务旨在以互联为核心，协同 PCB 业务，发挥公司电子互联产品技术平台优势，通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>